

特許出願中

超低背パッケージ

特長

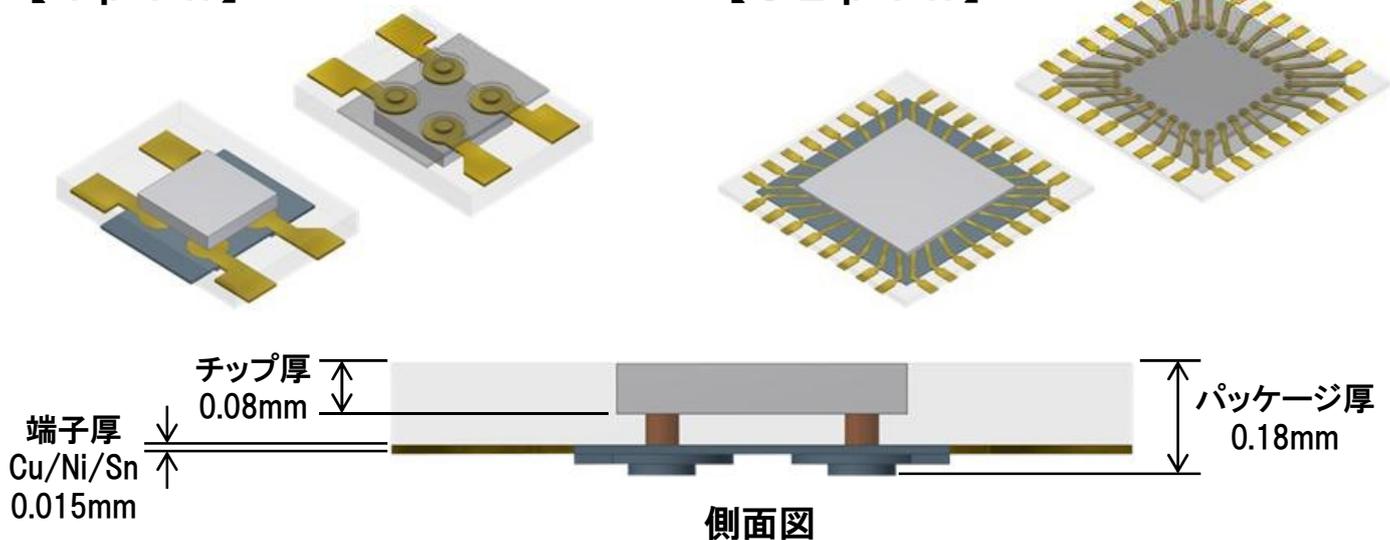
■新しいパッケージ構造の超低背パッケージを独自技術により開発・提供を予定しております。

- ・従来のCuフレームやPCB等のインターポータを使用しない構造により超低背・低抵抗配線のパッケージを実現します。
- ・安価なイニシャル費用でパッケージを立ち上げます。

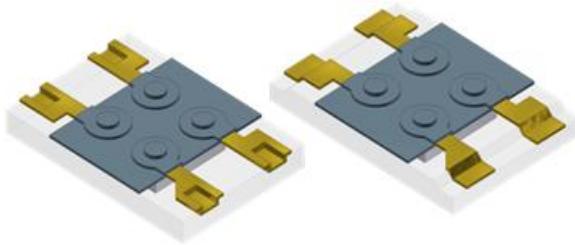
UTPP (Ultra Thin Plating Package) と名付けました。

【4pin】

【32pin】



端子部の窪み加工



端子部に窪み加工を施すことではんだフィレットが形成でき、実装後の外観検査性を向上することも可能です。